

第 30 回宇宙用部品連絡会アジェンダ

日時： 平成 25 年 8 月 30 日（金） 14 : 00～17 : 45

場所： 筑波宇宙センター 総合開発推進棟 1F 大会議室

1. 開会の挨拶
2. JAXA からの情報 (14 : 00－14 : 50 50 分)
 - 2.1 GOSAT-2 の紹介
 - 2.2 宇宙用はんだ付工程標準の最新化に向けた取り組み
 - 2.3 JAXA-QTS-2000 の改定計画
 - 2.4 JPPL の作成計画について
3. 部品ユーザからの情報 (14 : 50－15 : 10 20 分)
 - 3.1 NEC 東芝スペースシステム(株)
 - 3.2 三菱プレシジョン(株)
4. 部品メーカーからの情報 (15 : 10－16 : 20 70 分)
 - 4.1 n チャネルパワーMOSFET（改良品）の新規認定（状況報告）／富士電機(株)
 - 4.2 チップ形ヒューズの新規認定（状況報告）／(株)立山科学デバイステクノロジー
 - 4.3 高密度小型パッケージ搭載対応プリント配線板の新規認定（状況報告）／山梨アビオニクス(株)
 - 4.4 ネットワーク抵抗器の新規認定（結果報告）／多摩電気工業(株)
 - 4.5 固定皮膜抵抗器（RNS55J）の再認定（結果報告）／多摩電気工業(株)
 - 4.6 固定皮膜抵抗器の新工場新設（状況報告）／多摩電気工業(株)
 - 4.7 固定皮膜抵抗器（RLS(C)、RNS90C 及び RZSS）の認定辞退／多摩電気工業(株)
 - 4.8 POL DC/DC コンバータの再認定（結果報告）／日本アビオニクス(株)
 - 4.9 FPGA のユーザサポートについて／HIREC(株)
- ◆休 憩◆ (16 : 20－16 : 35 15 分)
5. 部品生産のスケジュールに関するお知らせ (16 : 35－16 : 55 20 分)
 - 5.1 POL DC/DC コンバータ（新規募集）／日本アビオニクス(株)
 - 5.2 積層セラミックコンデンサ（N2040/L104）の部品標準化とフォーキャストの共有について（状況報告）／(株)福井村田製作所
 - 5.3 HR5000 及び BSRAM のウエハ生産終了について／HIREC(株)
 - 5.4 EEPROM のウエハ生産終了について／HIREC(株)
6. QPL/QML 部品認定状況報告 (16 : 55－17 : 05 10 分)
 - 6.1 共通部品等の認定状況
 - 6.2 QTS/ADS の改定状況
 - 6.3 認定部品の変更管理状況
7. 海外情報 (17 : 05－17 : 40 35 分)
 - 7.1 海外宇宙機関 関連情報
 - 7.2 G12/11 報告
 - 7.3 ESA との協定延長報告
8. その他 (17 : 40－17 : 45 05 分)
 - 8.1 宇宙用部品データベースに関するお知らせ
 - 8.2 今年度のイベント紹介
9. 閉会の挨拶

意見交換会（18 : 30～20 : 30）

※会場までバスにて送迎いたします。